

高精度形状測定システム

Laser Measurement System



そり・たわみ・厚さ測定に最適

For Measuring Flatness and Thickness.

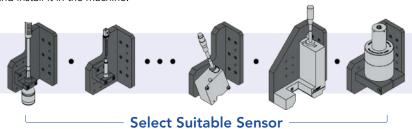




装置の概要 Machine Overview

測定物・測定項目に最適なセンサを選び、装置に組み込みます。

Select the most suitable sensor for measurement objects and items, and install it in the machine.





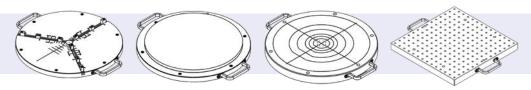
様々なワークの測定に対応 Supports Various Works Measurements

ワークタイプ Work Type	Wafer	Glass/QZ	Resin	Substrate
平坦度 Flatness				
厚さ Thickness				△*1

カスタマイズも可能な数種のワークホルダ Several Customizable Work Holders

300mmの測定領域に対して、数種のワークホルダをご用意しています。 試料に合わせたカスタマイズも可能です。

Several types of work holders are available for a measurement area of 300 mm. Customization according to the sample is also possible!



安全対策を標準装備 With Safety Measures as Default

装置本体に金属製の装置カバーとライトカーテンによる安全対策 およびシグナルタワーによる状態の表示を標準にて搭載しています。 お客様の設備基準に合わせたカスタマイズも可能です。

The machine body is equipped with safety measures using a metal device cover and light curtain, and a status display using signal tower as default. Customization according to factory standards is also possible!



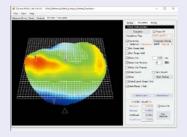
様々な機能を持つ計測・解析ソフトウェア Measurement Software with Various Functions



[様々な測定動作に対応 Support Various Operations]

計測用ソフトウェアは、指定範囲測定(矩形・內接円)・間引き測定・ポイント 測定・複数エリア測定など、様々な計測動作に対応しています。

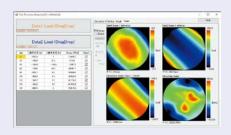
The measurement software supports various operations such as Square area, Inscribed Circle area, Thinning, Line, Point, and Batch measurement of multiple areas.



「様々な解析動作に対応 Support Various Analysis]

計測用ソフトウェアは、プロファイル解析やSORI・Bow・WARP・GBIR等のSemi 規格測定に対応しています。また、データのCSV形式や解析結果のレポート出力も可能です。

The measurement software supports profile analysis and Semi Standard measurement such as SORI, BOW, WARP and GBIR. It is also possible to output data in CSV format and analysis results as a report.



[**応力解析に対応**(オプション) Support Stress Analysis (option)]

成膜前後のSORI形状の測定データを用いて、膜応力の分布を算出します。 また、解析結果のレポート出力が可能です。

The distribution of film stress is calculated using the SORI shape data before and after thin film formation.

In addition, analysis result report output is possible!

装置仕様 Specifications

型式 Model	DY-3001YM	
測定項目 Measurement Item	表面の平坦度・厚さ・Semi 規格測定 (SORI/ BOW/WARP/GBIR 他) Surface Flatness, Thickness, TTV, Semi Standard Measurements.	
測定対象 Measurement Target	半導体ウェハ Semiconductor Wafer (Si, SiC, GaN, Ga ₂ O ₃ , LT, LN, GaAS, ··· etc.) ガラス・石英等の透明体材料 Transparent Material such as Glass and Quartz. フィルム/レジン/接着剤等の樹脂材料 Resin Materials such as Films, Resins, Adhesives, etc. 金属製の部品・電子基板の平坦度 Flatness of Metal Parts and Electronic Boards.	
測定範囲 Measurement Area	XY: □300 [mm], Z: センサーによる / By selected sensor	
分解能 Resolution	XY: 1 [um], Z: 0.01 [um]	
電源仕様 Power Supply	1Φ, AC100 - AC120V / AC200 - AC240V, 1,000 [VA]	
サイズ Size	≈ W: 1,700 × D: 1,000 × H: 1,470 [mm] (表示灯を除く/ Excluding indicator lights.)	
重量 Weight	≈ 450 [kg]	

カスタマイズ

CUSTOMIZE

測定領域の変更・安全対策の変更・ ワークホルダの製作等、 ご用途に応じてカスタマイズ可能です。

It can be customized according to the application, such as changing the measurement area, changing safety equipment, and manufacturing work holders.

サンプル測定

SAMPLE MEASUREMENT -

お客様のサンプルをお預かりして、 導入前のテスト測定を実施しています。 詳しくは、営業部までお問合せ下さい。

Pre-installation test measurements can be performed on your sample. For more information, please contact the sales department.

神津精機株式会社 Kohzu Precision Co., Ltd.

本社 / 工場 〒215-8521 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-15 HQ / Factory 2-6-15, Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-8521, Japan TEL 044-981-2131 / +81-44-981-2131

HP https://www.kohzu.co.jp/

E-Mail sales@kohzu.co.jp